



所内邮箱

用户名:

密码:



所长信箱

留言信箱

新闻中心

- 重要新闻
- 图片新闻
- 科研动态
- 学术交流
- 综合新闻
- 视频新闻



现在位置: [首页](#) > [新闻中心](#) > [科研动态](#)

理化所与企业联合研发的液态金属CPU散热器亮相第九届网博会

发表日期: 2011-11-01

打印 字体大小: 大 中 小 [【关闭】](#)

10月28日至31日,在北京展览馆举行的“第九届中国国际网络文化博览会”上,由中科院理化所与北京依米康科技发展有限公司联合研发的液态金属CPU散热器首次与广大游戏玩家见面。此款面向高端CPU市场开发的散热器产品,历时两年打造,经实际测试,其性能、噪音、耐热极限等方面相对于传统的风冷、水冷及热管技术均表现出独特的优势,更加适合高性能计算机、服务器、数据中心等使用。

近年来,随着芯片功率密度持续攀升,“热障”问题日益成为制约高性能计算机进一步发展的瓶颈,传统热管理方法渐显力不从心。理化所科研人员于2002年首次将液体金属介质引入到计算机热管理领域,突破了国内外传统热管理技术理念,开创了具有重大实用价值的通用型室温金属流体芯片散热技术。在获得该技术首项底层发明专利后,通过多年研究持续拓展出一系列相关知识产权,并研制出在多个应用领域内有着广泛应用价值的液态金属散热器样机。此次参展产品正是部分成果向实际应用转化的一次成功尝试,相应工作得到了北京市重大产业化专项资金的资助。

在此次网博会“盛大游戏”展台亮相的液态金属CPU散热器,其正式产品预计将于11月面世。



液态金属CPU散热器亮相网博会



液态金属CPU散热器亮相网博会



展台



展台



版权所有：中国科学院理化技术研究所 Copyright © 2002-2008

地址：中国·北京 京ICP备05002791号